

2025年2月期（第40期） 決算説明資料



2025年4月11日
ローツェ株式会社
証券コード：6323
<https://www.rorze.com/ir>

注意事項

◆ 将来見通しに関する記述について

本資料に記載されている業績予想、将来予測などは、当社が現時点で入手可能な情報に基づき判断したものであり、その情報の正確性、完全性を保証したり、約束したりするものではありません。また、経済動向や業界における競争、市場、諸制度等の変化により大きく見通しが変動する可能性があり、今後予告なく変更されることがあります。

◆ 本資料における表示方法について

数 値： 単位未満を切り捨て

比 率： 1円単位の金額で計算後、単位未満四捨五入

会計年度： 年度開始日の暦年表記（「2025年2月期」を「FY2024」または「FY'24」と表記）

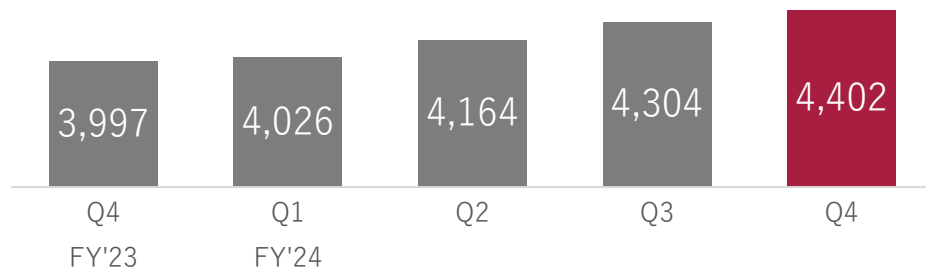
会計期間： 連結・当社、国内および海外子会社の会計期間は次のとおり

	Q1 (第1四半期)	Q2 (第2四半期)	Q3 (第3四半期)	Q4 (第4四半期)	通 期
連結・当社・国内子会社	3月～5月	6月～8月	9月～11月	12月～翌年2月	3月～翌年2月
海外子会社	1月～3月	4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～12月

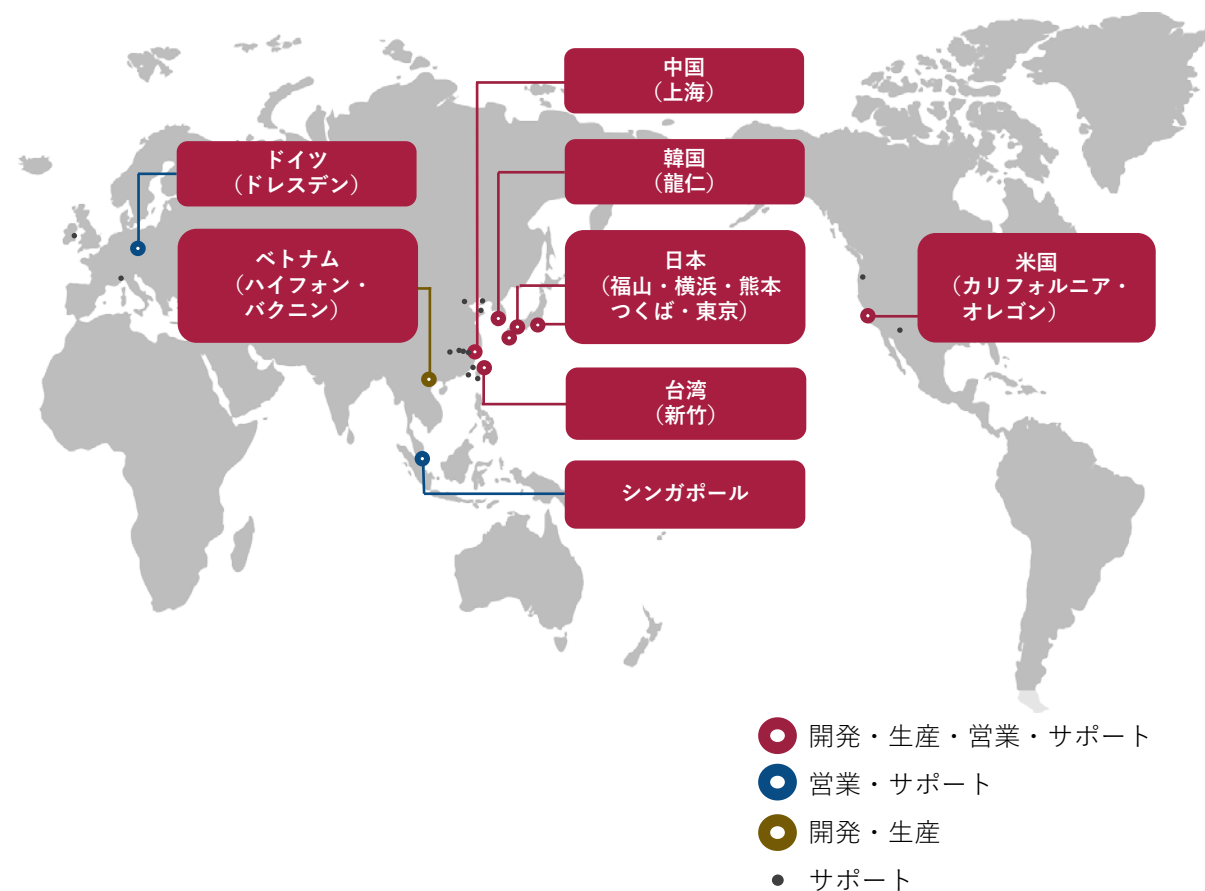
会社概要

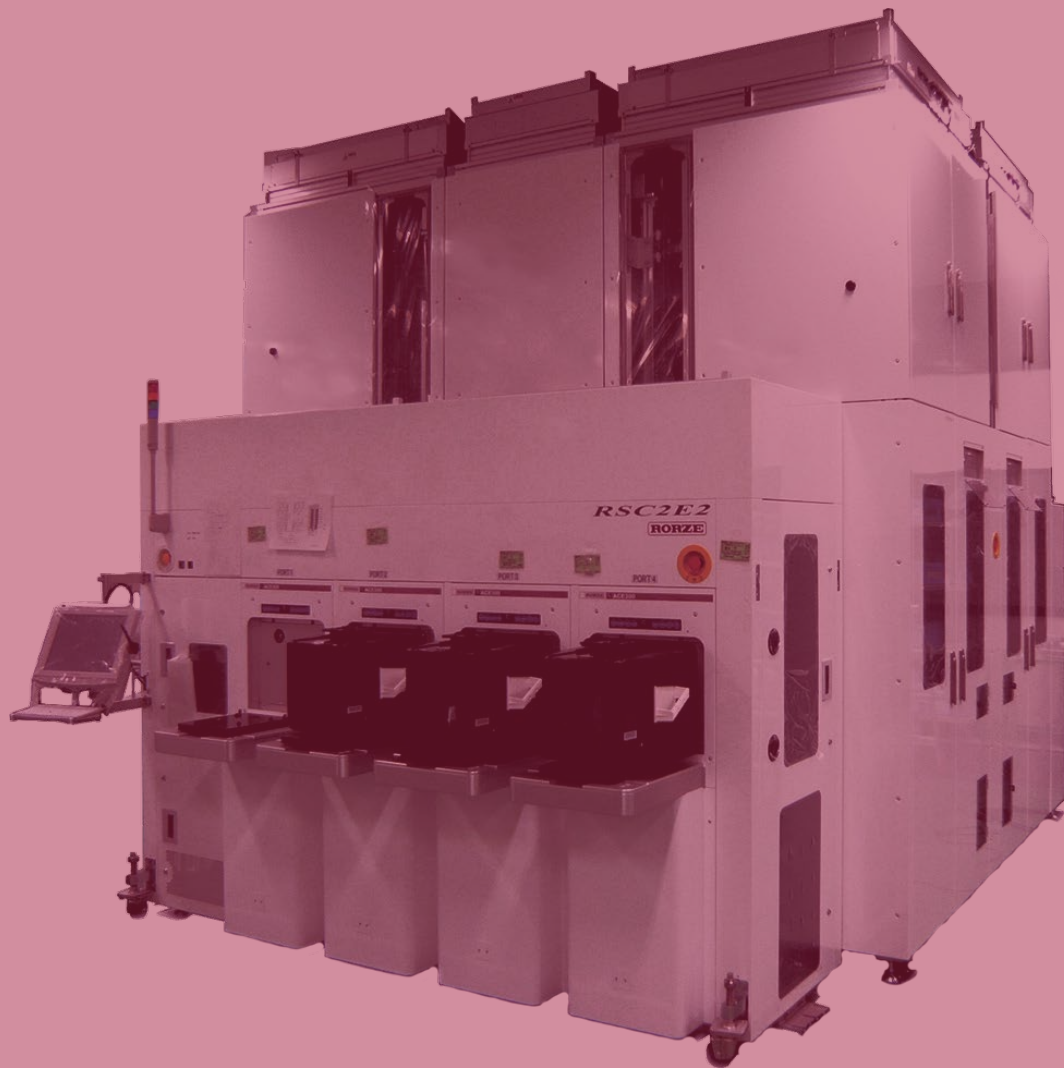
会社名 ローゼ株式会社（英文名；RORZE CORPORATION）
上場市場 東京証券取引所 プライム市場（証券コード：6323）
所在地 広島県福山市神辺町
設立 1985年3月30日
資本金 982百万円
事業内容 半導体・フラットパネルディスプレイ（FPD）・ライフサイエンス関連の自動化・搬送装置の開発・製造・販売
従業員数 連結：4,402名 当社：244名（2025年2月末現在）
事業拠点 国内：福山・横浜・熊本・つくば・東京
海外：米国・ベトナム・台湾・韓国・シンガポール・中国・ドイツ

従業員数の推移（連結）



グローバルネットワーク





2025年2月期（第40期）
（2024年3月～2025年2月）
連結業績

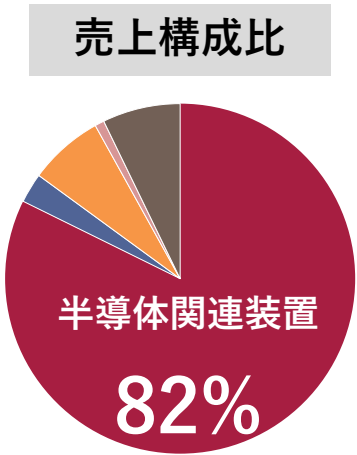
業績ハイライト

■ 半導体・FPD関連装置好調で売上高1,244億円を達成、量産強化や円安等で増収増益

		前 期 比
■ 売上高	124,406 百万円	+33.4%
■ 営業利益	32,024 百万円	+32.7%
■ 経常利益	35,454 百万円	+30.9%
■ 当期純利益	23,634 百万円	+20.7%

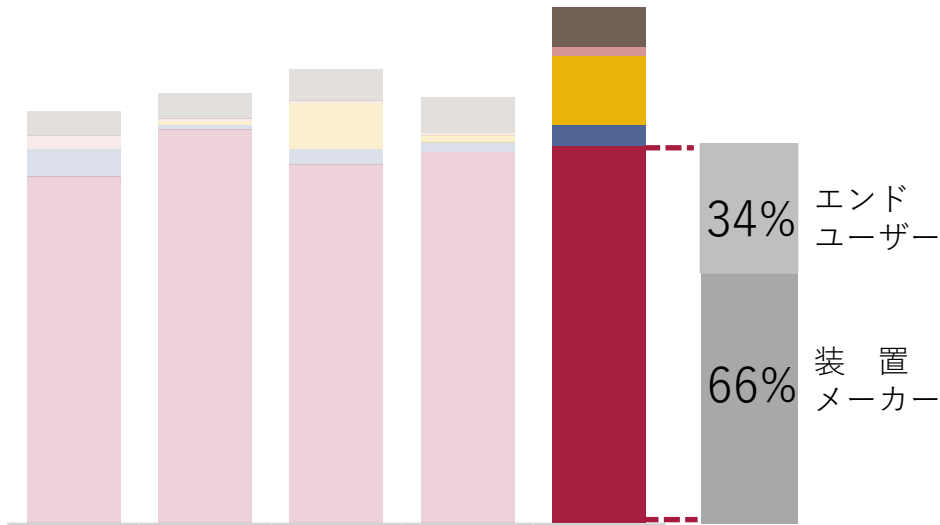
為替レート	
(円/USD)	
FY'24 期初予想	FY'24 通期実績
144	151

※ 2025年2月期より業績予想および実績は期中平均レートを使用



四半期売上高						
(百万円)		Q4 FY'23	Q1 FY'24	Q2	Q3	Q4
■ 部品・修理 他 ※		1,638	1,705	2,122	2,406	2,708
■ ライフサイエンス関連装置		919	152	181	171	568
■ FPD関連装置		1,152	262	3,130	496	4,705
■ 分析装置		742	331	1,030	616	1,446
■ 半導体関連装置		23,632	26,836	24,475	25,316	25,740

※ 2025年2月期より「モータ制御機器」は「部品・修理 他」に含めて集計しております。



2025年2月期 通期連結業績

	当期実績	通期計画	計画比(%)	前期実績	前期比(%)
売上高	124,406	120,784	103.0	93,247	133.4
半導体関連装置	102,368	102,399	100.0	78,946	129.7
分析装置	3,425	3,841	89.2	3,112	110.0
FPD関連装置	8,593	6,511	132.0	3,713	231.4
ライフサイエンス関連装置	1,074	1,300	82.6	1,220	88.1
※ 部品・修理 他	8,943	6,732	132.8	6,254	143.0
営業利益	32,024	31,617	101.3	24,138	132.7
経常利益	35,454	31,518	112.5	27,076	130.9
親会社株主に帰属する 当期純利益	23,634	22,916	103.1	19,576	120.7

※ 2025年2月期より「モータ制御機器」は「部品・修理 他」に含めて集計しております。

■ 半導体関連装置売上高1,023億円 (前期比30%増)

生成AI需要拡大等に伴う先端半導体向けの設備投資増加

- ・ 米国主要装置メーカーが前期比増
- ・ 台湾ファウンドリへの装置納入が好調

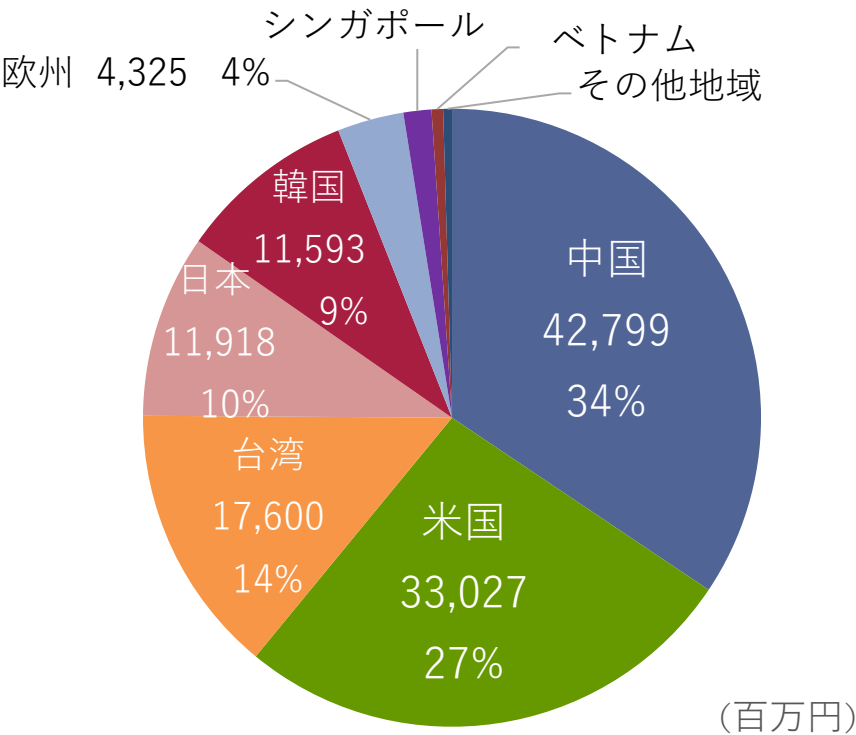
■ FPD関連装置売上高85億円 (前期比131%増)

- ・ 韓国主要取引先からの前工程用大型搬送システム受注増で装置納入進む

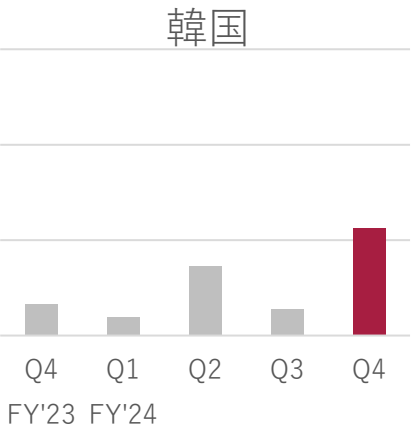
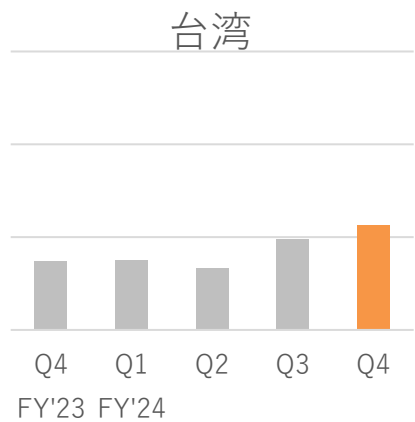
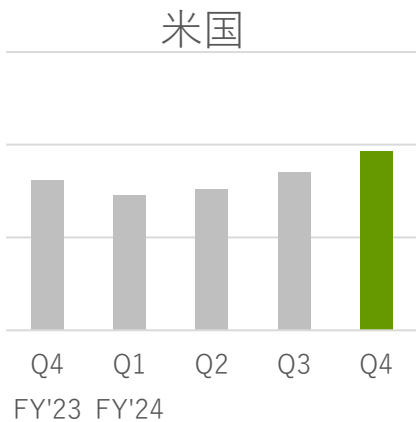
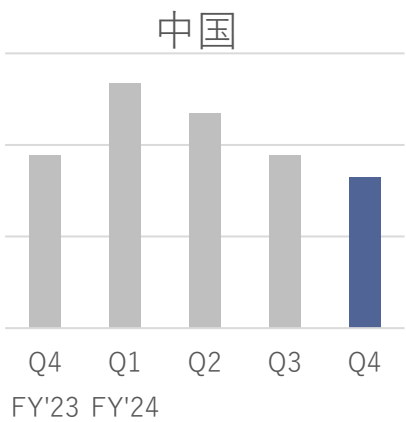
■ 経常利益は増収効果および円安等で増益

地域別売上高

■ 中国割合が減少し、米国・台湾・日本が増加、韓国FPD関連装置の増加



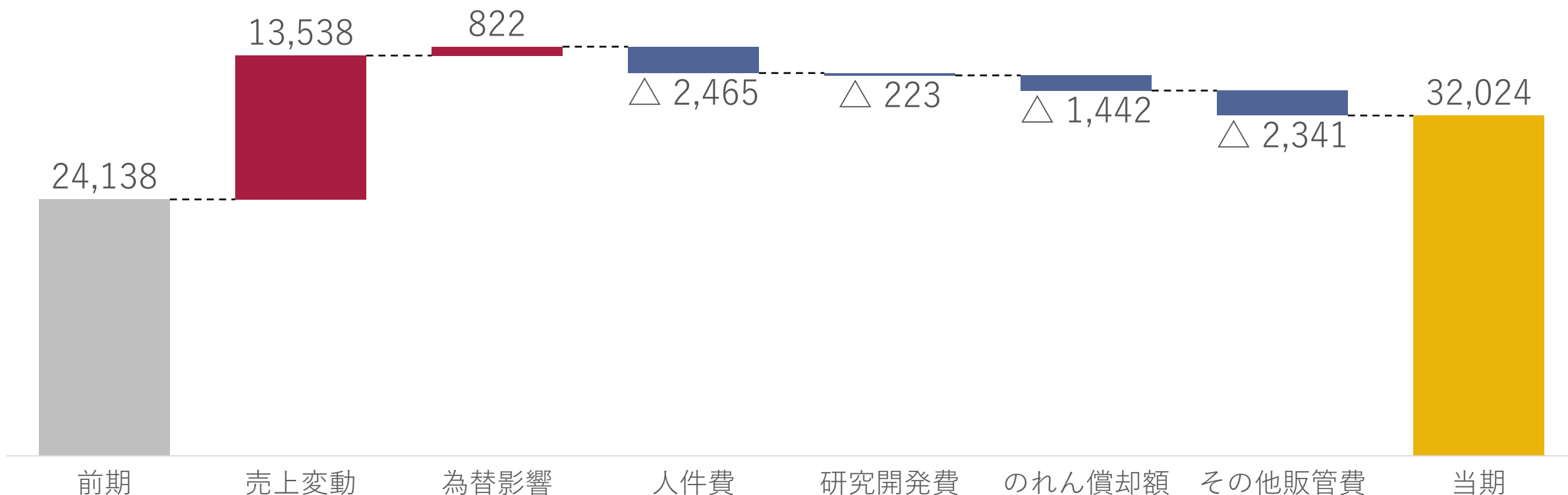
※ 「地域別売上高」は顧客企業の本社所在地別に集計



営業利益の増減要因

■ 人件費・のれん償却等は増加するも、半導体・FPD関連装置売上増により増益確保

(百万円)

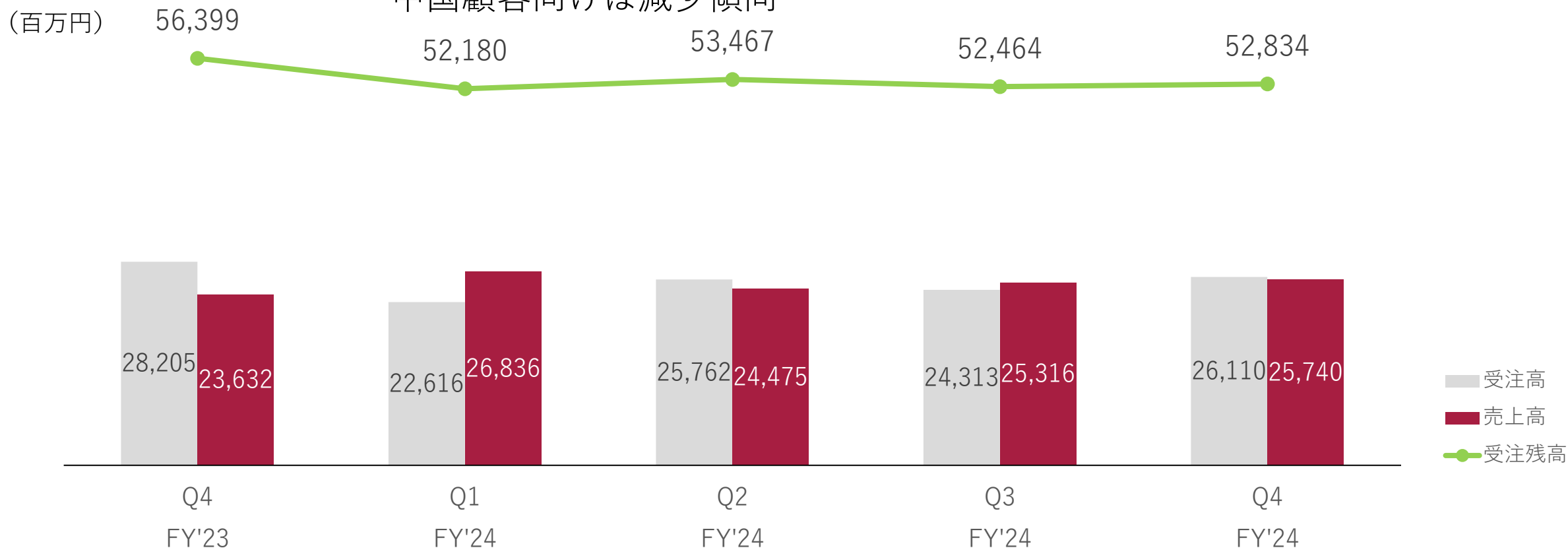


※ 連結営業利益に対するNanoverse社の影響額：▲3,059百万円（のれん償却額 1,425百万円、同社営業損失：1,633百万円）

受注高・売上高・受注残高の推移

半導体関連装置

- ・売上高は、中国向けが減少するも台湾・米国の先端半導体向けが増加
- ・受注高は、一部メモリーメーカー向け、アドバンスドパッケージ関連が増加、中国顧客向けは減少傾向

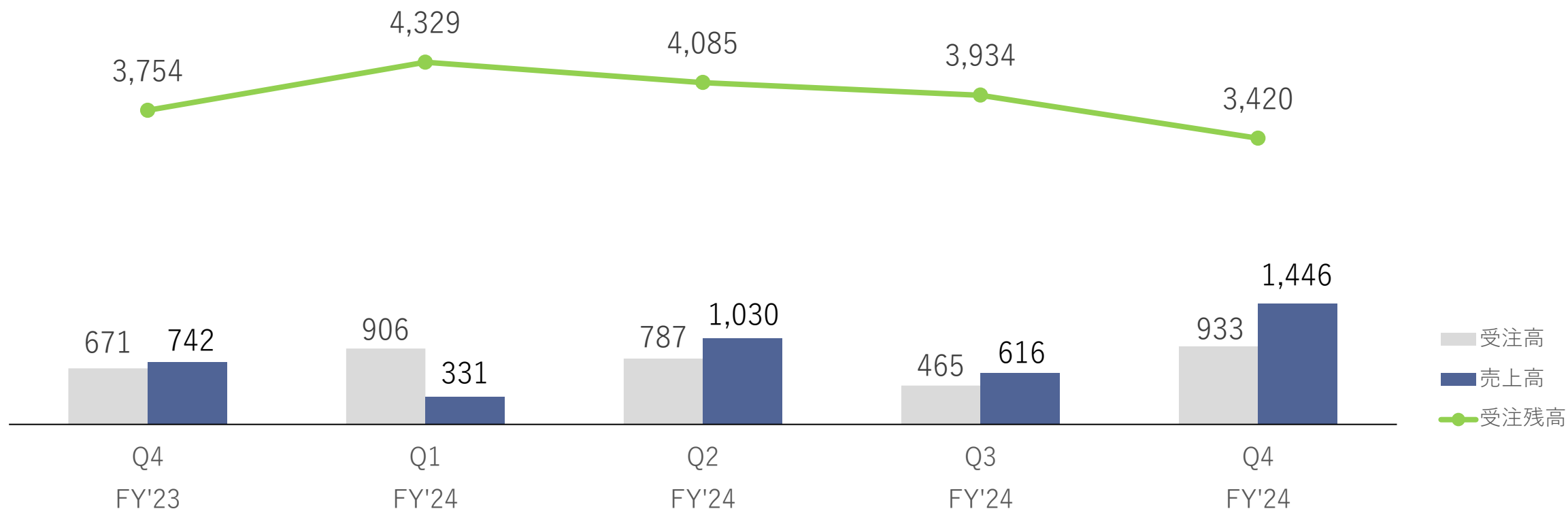


受注高・売上高・受注残高の推移

分析装置

- ・売上高は、デバイスメーカー、日欧研究機関向け等により持ち直し
- ・受注高は、ウエハメーカー向けの受注が増加

(百万円)

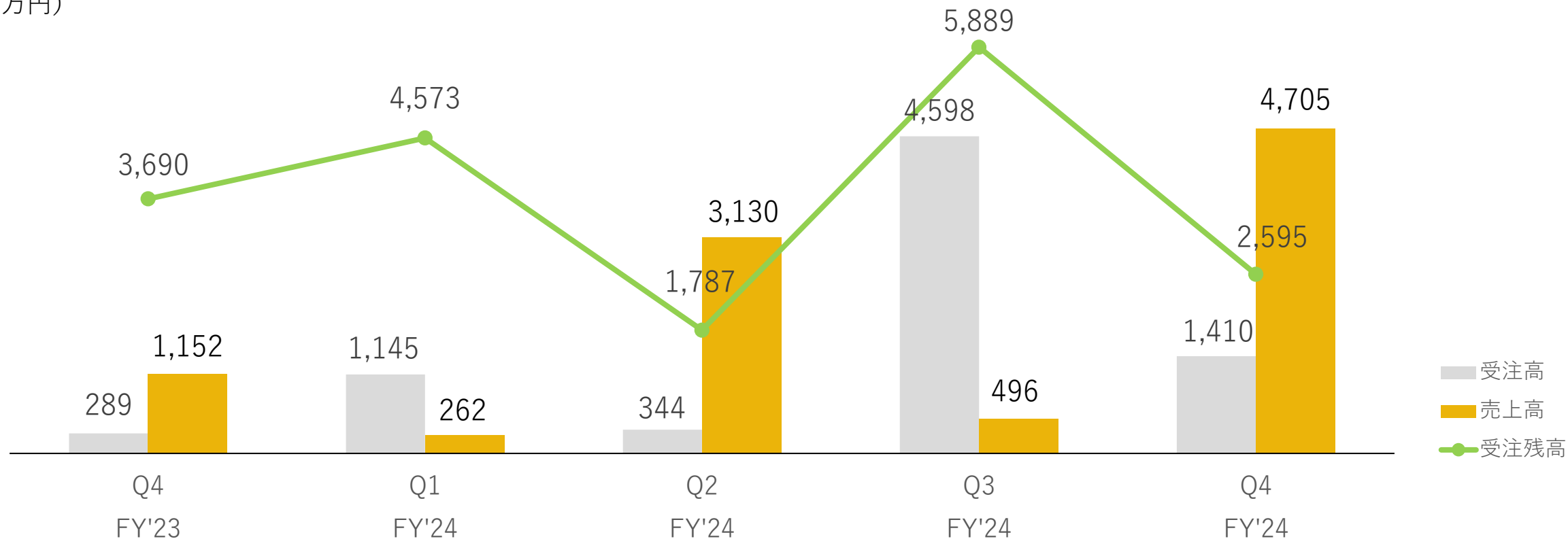


受注高・売上高・受注残高の推移

FPD 関連装置

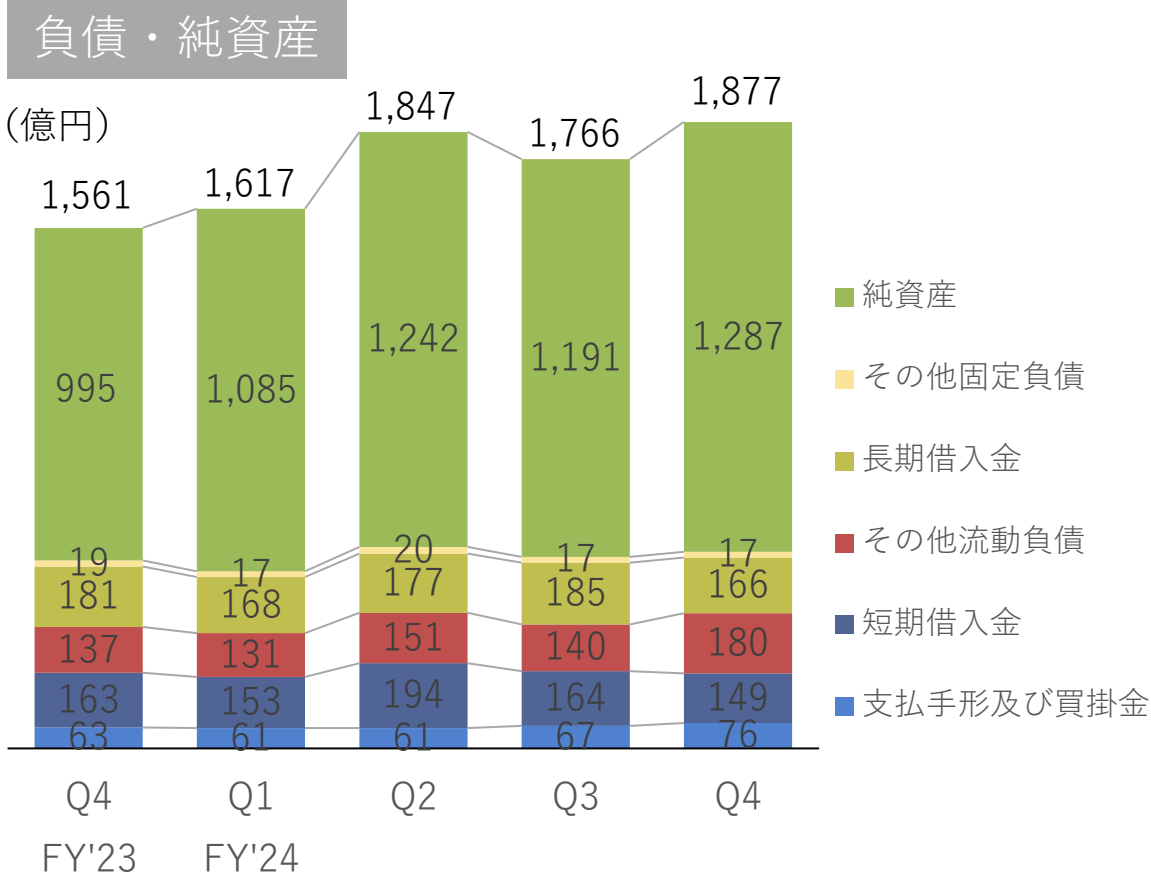
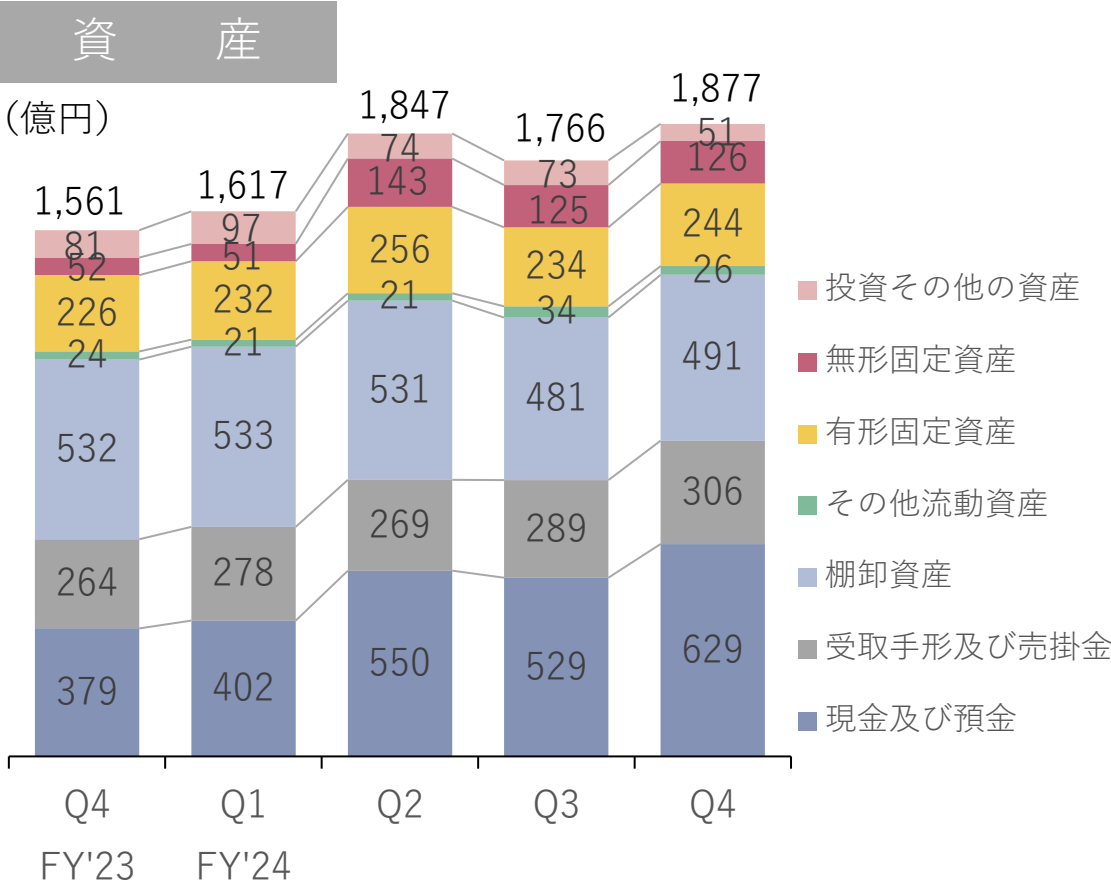
- ・売上高は、Q3に受注した前工程用大型搬送システムの装置納入が進み急増
- ・受注高は、Q4で新規に前工程用大型搬送システムの装置を受注

(百万円)



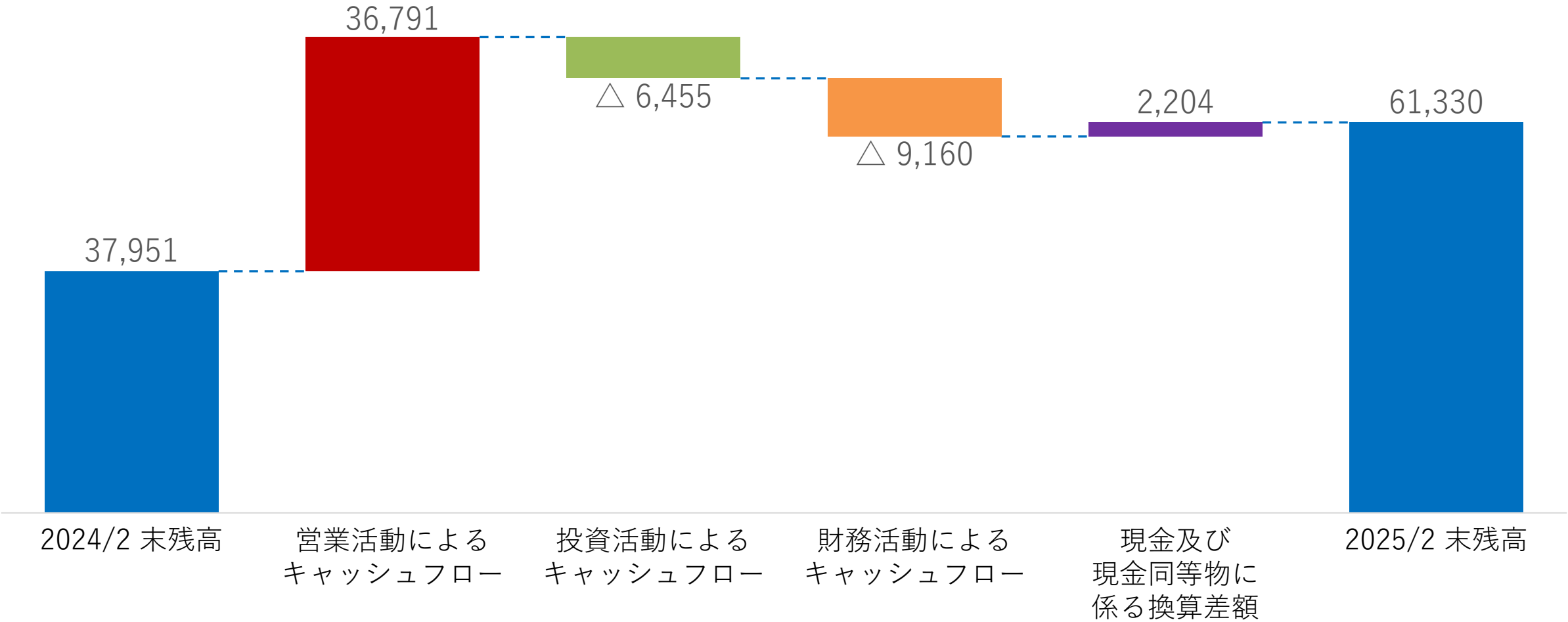
連結貸借対照表

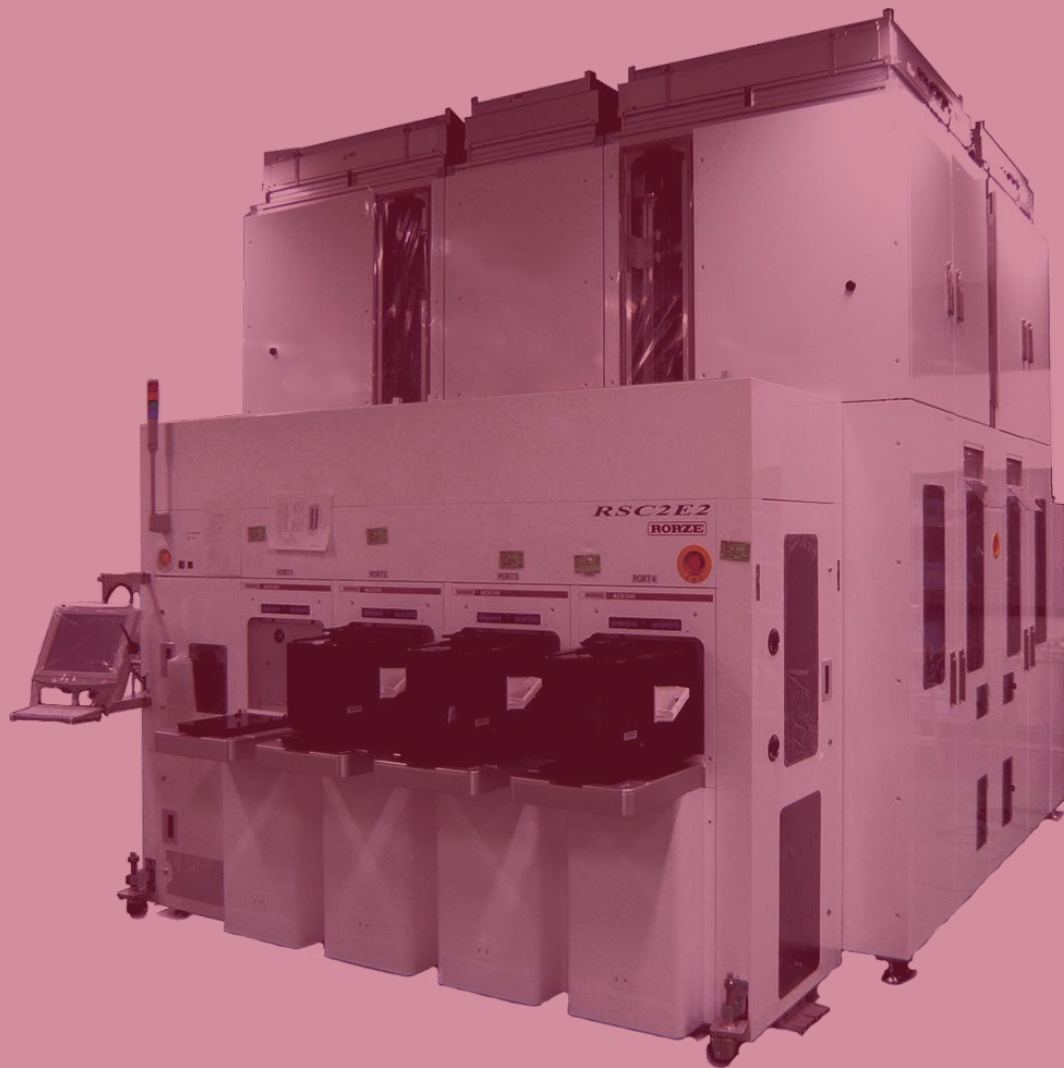
■ 増益に伴う高水準の現金及び預金により自己資金での大型設備投資等が可能に



2025年2月期 連結キャッシュ・フロー

(百万円)





2026年2月期（第41期） 今後の見通し

2026年2月期 今後の見通し

【事業環境】

- 経済安全保障として、米国による対中輸出規制強化の一方、各国で自国の半導体生産力確保のための政府支援が継続し、半導体のサプライチェーンは地政学的分断の局面
- 米国による関税措置の影響

- AI技術の発展とデータ処理需要の増加により、最先端・高性能な半導体需要が拡大
- 高いデバイス密度と機能拡張実現のため、アドバンスドパッケージ関連の半導体設備投資加速

【今後の見通し】

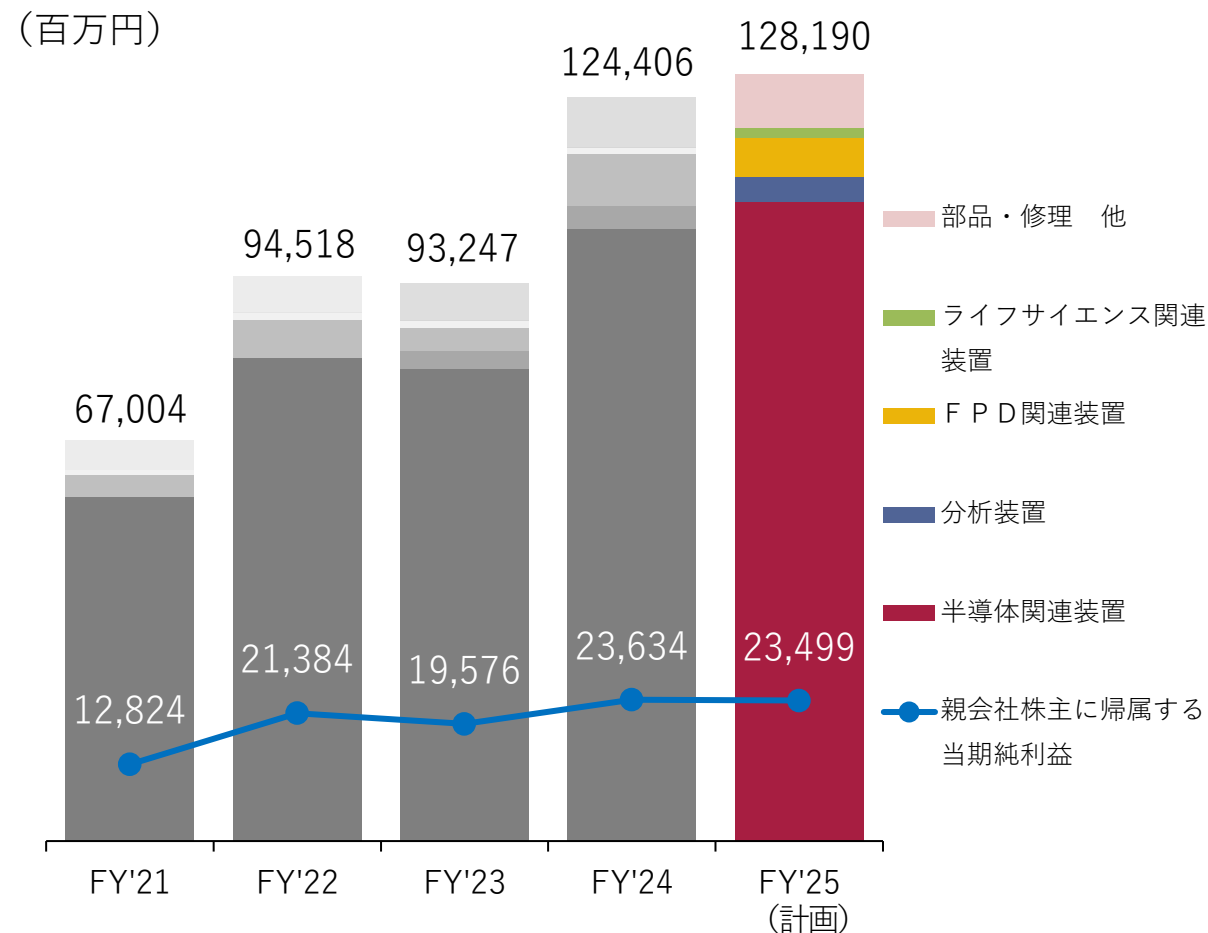
- 半導体関連装置
 - ・ 台湾ファウンドリ等の旺盛な半導体設備投資に対応
先端半導体向けやアドバンスドパッケージ用の搬送装置
納入拡大
 - ・ 米国や中国向けEFEMおよびメモリ向け装置の受注納入
は前期並み需要を想定
- 分析装置
 - ・ 新規装置の受注拡大の傍ら、当社グループでの営業・
サービス体制の強化を進捗
- FPD関連装置
 - ・ 今期売上は前期大型設備導入の反動減を想定
- ライフサイエンス関連装置
 - ・ 新規装置開発の充実およびジェノスタッフ社業績の通年
寄与

2026年2月期 通期連結業績見通し

	2026/2期 予想(百万円)	2025/2期 実績(百万円)	前期比 (%)
売上高	128,190	124,406	103.0
半導体関連装置	106,893	102,368	104.4
分析装置 ※2	4,163	3,946	105.5
FPD関連装置	6,550	8,593	76.2
ライフサイエンス関連装置	1,590	1,074	148.0
部品・修理 他 ※2	8,992	8,423	106.8
営業利益	30,345	32,024	94.8
経常利益	30,618	35,454	86.4
親会社株主に帰属する 当期純利益	23,499	23,634	99.4
為替レート(円/USD) ※1	152	151	—

※1 2025/2期より、業績予想および実績は期中平均レートを使用しています。

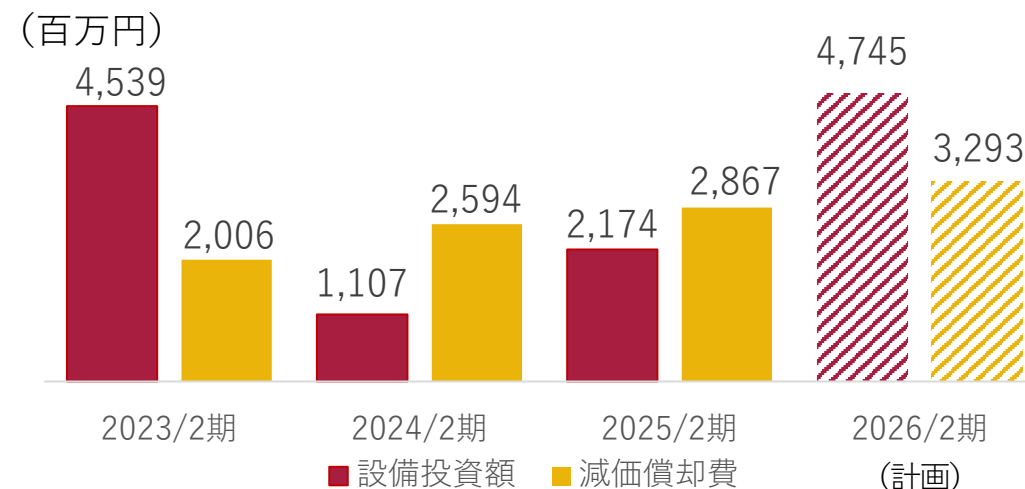
※2 2026/2期では、製品別売上高の集計範囲を見直しています。上表では2025/2期について比較可能な数値に再集計し記載しているため、「分析装置」および「部品・修理 他」について、本頁より前と異なる数値となっています。



設備投資額・減価償却費・研究開発費

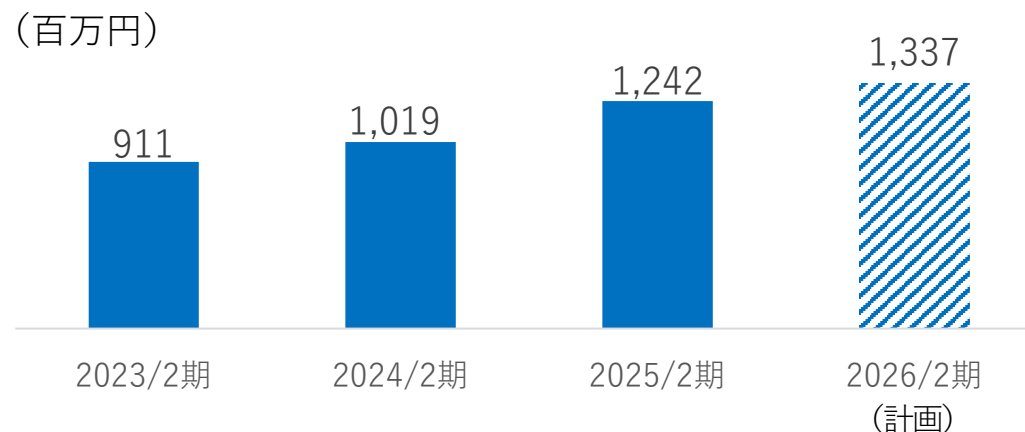
◆設備投資・減価償却

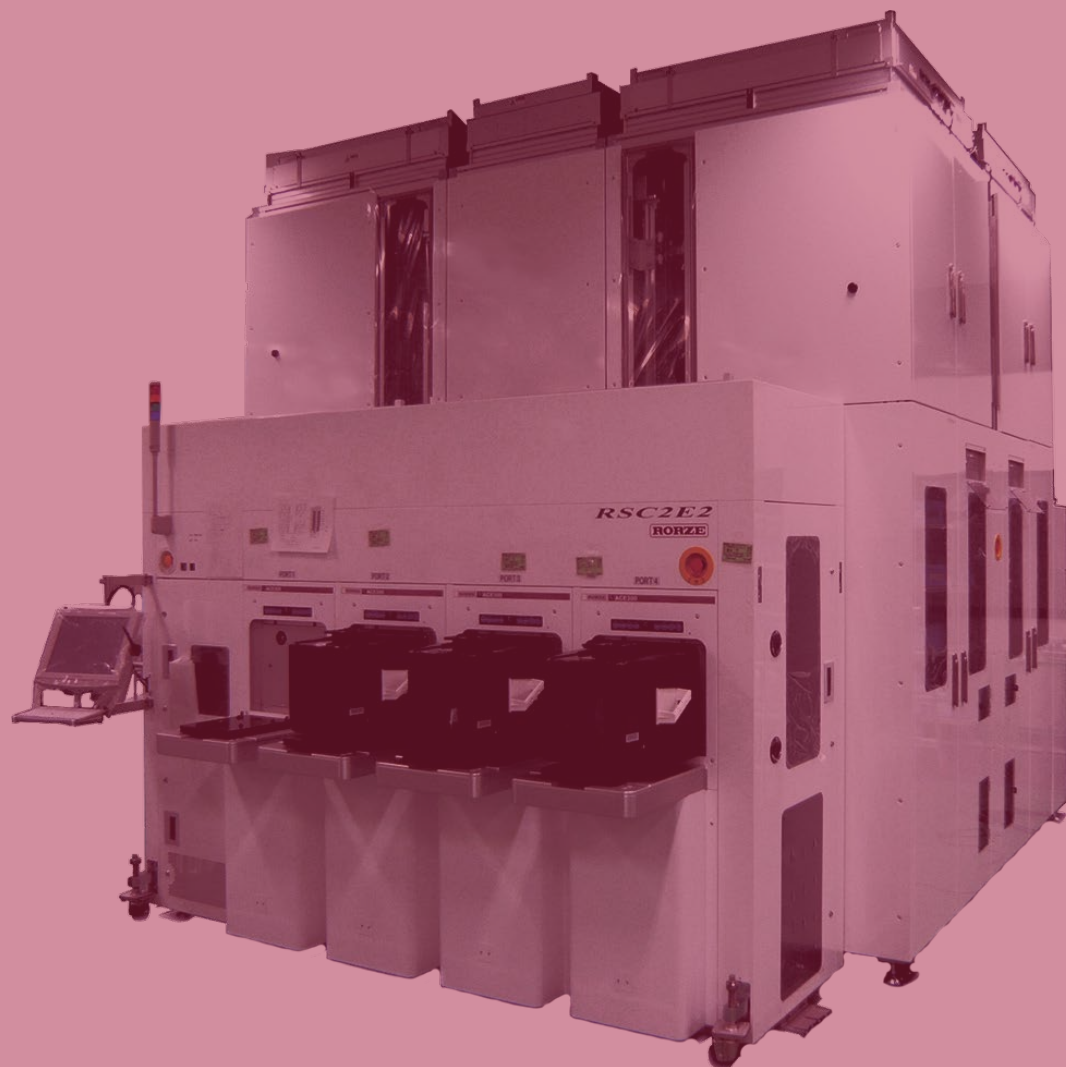
- ・ベトナム現有工場の組立自動化用機械設備導入および加工機械設備更新
- ・ベトナム新工場の土地確保資金
省庁再編等に伴う許認可手続き遅延により用地の正式取得は2026年となるものの、同年着工、翌年第1期竣工の予定
- ・従業員増加に対応した本社整備
- ・米国子会社オフィスのクリーンルーム拡張
- ・減価償却費は33億円を予定



◆研究開発

- ・真空用搬送装置の新製品開発
- ・アドバンスドパッケージ用の搬送装置の開発
- ・次世代製品のための要素技術開発





トピックス

補足事項

■ 特別損失（投資有価証券評価損）

関係会社Shanghai ReMed Biotechnology Co., Ltd.は、当社のライフサイエンス部門と協働し、中国での再生医療分野において、臨床試験および自動細胞培養装置導入等を手掛け、2024年は黒字計上しています。しかしながら、主要医療機関において、コロナ対応による混乱やその後の汚職防止を背景とした粛清の影響等を背景に先端医療である細胞培養ニーズが伸び悩み、早期に市場の高成長を前提とした事業計画を達成することは困難と判断しました。これに伴い、同社の株式について2025年2月期に評価損21億円を計上しました。

■ 連結子会社NanoverseTechnologies, Ltd（NV社）の連結業績への影響額

	2025/2期 実績	2026/2期 予想
営業利益影響額	△30億円	△60億円
（のれん償却額）	（14億円）	（28億円）
（NV社の営業損失）	（16億円）	（32億円）
親会社株主に帰属する 当期純利益 影響額 *	△20億円	△38億円

* 親会社株主に帰属する当期純利益影響額は、概ねNV社の営業損失の33%相当(当社持分割合)とのれん償却額とを合計した額

* なお、開発中の装置の売上計上時期は2027年2月期以降となる見込み

ローツェイアス

■ 社名変更

2023年3月よりローツェグループ入りした株式会社イアス（代表：川端克彦、本社：東京都日野市）は、2025年3月1日よりローツェイアス株式会社へ社名変更いたしました。

【新社名】 ローツェイアス株式会社（英語表記: RORZE IAS Inc.）



【新HP】 <https://rorze-ias.com/>

（参考）2年間の経営統合成果
主要顧客向け販売・サービス業務のグループ内への取込および装置内の搬送機構のローツェ製品への置換を実施しました。



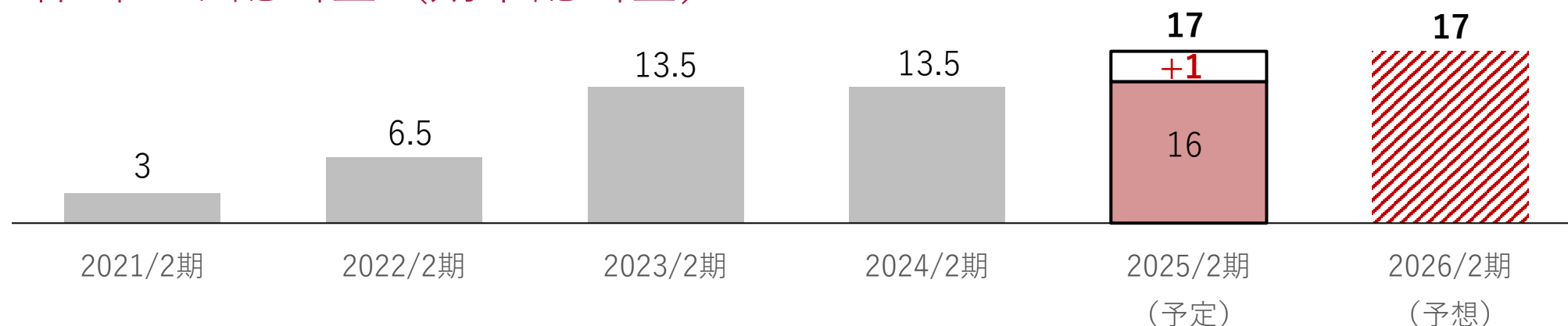
ローツェイアスの新製品LAGM/Expert LA（分析装置）は、新技術によるウエハ含有異物検出機能が高く評価され、最先端半導体技術センター(通称LSTC)等に納入されています

株主還元

■ 株主還元について

当社は、株主に対する利益還元を経営上の重要課題のひとつと認識し、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定的な配当の維持を基本とし、業績の推移及び財務状況等を総合的に勘案して利益還元を行う方針であります。

■ 1株当たり配当金（期末配当金）



※ 2024年9月1日を効力発生日として普通株式1株につき10株の割合で株式分割を実施しています。

そのため1株当たり配当金は当該株式分割の影響を考慮した金額を記載しています。

※ 2025年2月期の1株当たり配当金は、期初計画の16円から1円増配し17円の予定です。

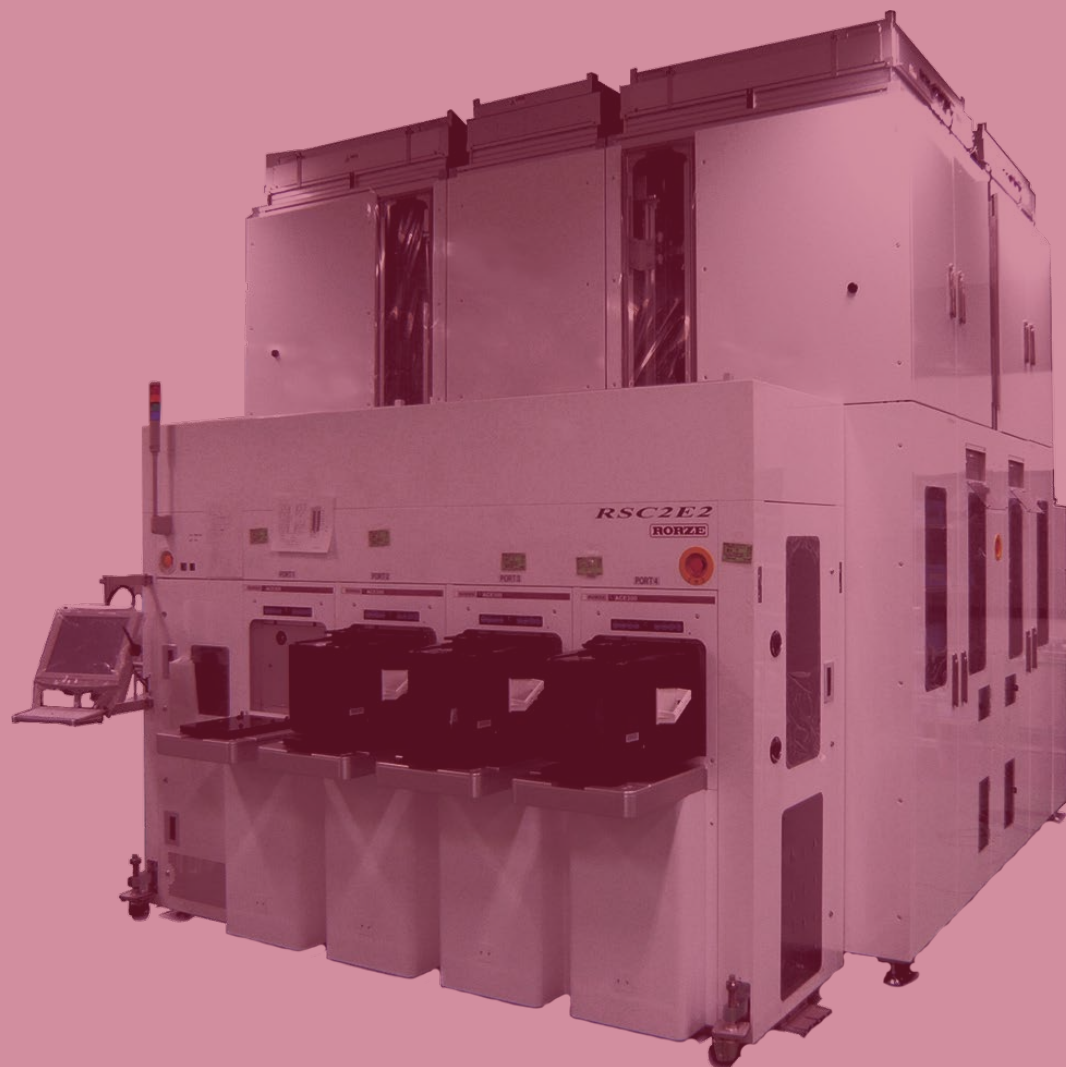
自己株式の取得

- ・ 資本効率の向上および株主への利益還元のため

取得対象株式の種類	当社普通株式
取得し得る株式の総数	5,300,000株(上限) (発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合 3.0%)
株式の取得価額の総額	50億円(上限)
取得期間	2025年4月14日から2025年7月31日
取得方法	東京証券取引所における市場買付

(ご参考) 2025年2月28日時点の自己株式の保有状況

- ・ 発行済株式総数 (自己株式を除く) 176,365,140株
- ・ 自己株式数 34,860株



参 考 資 料

半導体関連装置

RORZE

ユニット



大気用搬送ロボット



アライナ



ロードポート

システム



EFEM



真空プラットフォーム

システム



ウエハソータ



N2パージウエハストッカ

装置メーカー

プロセス装置

検査装置

エンドユーザー

デバイスメーカー

ウエハメーカー

アドバンスドパッケージ用装置

アドバンスドパッケージ

より小さいフットプリントで高いデバイス密度と機能拡張を実現できるようにチップレットを接続する方法

■PCB(プリント基板)上でのパッケージング

前工程 1 ウェハで1種類のチップ

これまでのローツェ搬送装置の市場

中工程 後工程のパッケージングをする代わりに、
・ウェハを薄くしてシリコンを貫通する通信用の縦穴形成 (TSV: Through Silicon Via)
・インターポーザ (※) 上で**複数のウェハを3Dに積層する**

ローツェの搬送装置が必要な新市場が拡大 (前工程 + 中工程)

後工程 1 パッケージで1種類のチップ

PCB基板上にマウンターでパッケージング
(各半導体間はPCB基板を通じて通信)

■シリコンウェハ上でのパッケージング

● アドバンスドパッケージ用装置

- ・ Tape Frame Sorter
- ・ PLP EFEM など

※インターポーザ： 貫通電極によって表裏の回路の導通をとり中継する基板
(シリコンインターポーザ、ガラスインターポーザ、有機インターポーザ)

アドバンスドパッケージ用装置



PLP用EFEM



Tape Frame用ソーター



分析装置



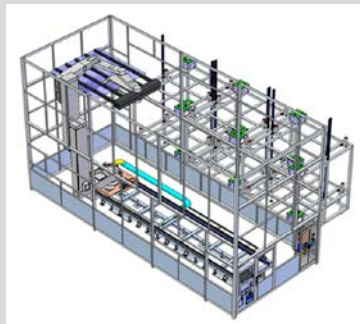
半導体業界
製造装置メーカー
エンドユーザー
デバイスメーカー
ウエハメーカー

半導体業界以外
研究機関
環境計測機器
化学薬品メーカー
など

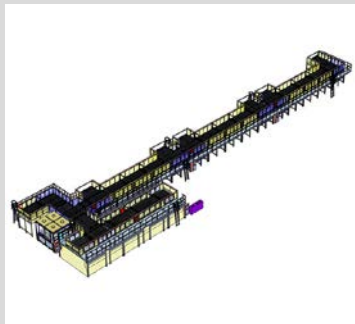
FPD関連装置

RORZE

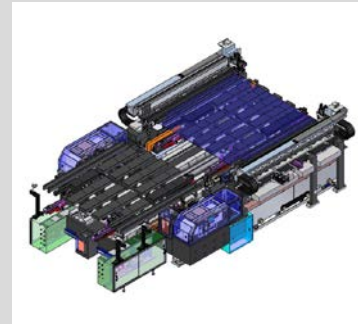
ローツェシステムズ
(韓国子会社)



INDEX超大型搬送システム



インライン搬送システム



レーザーカッティング装置



ディスプレイモジュール機器



Packing 超大型Cell装置

前工程：

FPDメーカー
FPD用ガラスメーカー

後工程：

FPDメーカー

ライフサイエンス関連装置



インキュベータ
SCALE48



自動培地交換機能&細胞観察
機能付きCO2インキュベータ
CellKeeper® II 48Plus



モバイルロボット



全自動培地交換システム
CellFarm(L)-360™



スケジューリングソフトウェア
Green Button Go™ ※
(※Biozero社製)

大学・製薬企業等
研究機関
再生医療関連企業



ありがとうございました